

BOLIX P



Zgodny z normą
PN-EN 12004

C2T

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca

ECHY PRODUKTU:

- podwyższona przyczepność (C2) do podłoża
- obniżony spływ (T) – możliwość przyklejania płytek od góry do dołu
- mrozoodporny
- dostosowany na hydroizolacje podpłytkowe w pomieszczeniach wilgotnych
- dedykowany do przyklejania ciężkich płytek z gresu, klinkieru i okładzin kamiennych na mocno obciążanych podłożach
- na podłoża mocno obciążone, tj. posadzki przemysłowe

PODŁOŻA:

Wewnątrz i na zewnątrz:

- jastrychy i posadzki cementowe,
- beton, beton komórkowy, beton lekki, żelbet,
- tynki cementowe i cementowo – wapienne,
- jednorodne mury o pełnych spoinach,
- płyty cementowo – włókniste,
- hydroizolacje, w tym BOLIX HYDRO i BOLIX HYDRO DUO.

Wewnątrz:

- płyty gipsowo – kartonowe,
- tynki gipsowe i anhydryt.

MATERIAŁY DO MONTAŻU:

Płytki małego i średniego formatu:

- ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier),
- kamienne niewrażliwe na przebarwienia,
- betonowe.

PRZEZNACZENIE:

- klej do montażu płytek (2 ÷ 10 mm),
- szpachla wyrównawcza do 5 mm,
- na zewnątrz i wewnątrz,
- do pomieszczeń mokrych, w tym łazienek, toalet, pralni kabin natryskowych, publicznych pomieszczeniach sanitarnych,
- na podłoża mocno obciążone, tj. garaże, warsztaty, posadzki przemysłowe, ciągi komunikacyjne,
- na ściany i podłogi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się aby nowe podłoża były odpowiednio wysezonowane:

- | | |
|---|--|
| - szpachla BOLIX SPN | min. 2 dni |
| - jastrych BOLIX PC-B | min. 1 dzień – przed przyklejeniem okładzin ceramicznych |
| | min. 2 dni – przed przyklejeniem okładzin kamiennych |
| - jastrych PC-S | min. 2 dni |
| - jastrych BOLIX PC | min. 7 dni |
| - jastrychy anhydrytowe | wilgotność ≤ 0,5% |
| - podłoża gipsowe | wilgotność ≤ 1,0% |
| - beton, beton lekki | min. 3 miesiące, wilgotność < 4% |
| - wylewki cementowe, tynki cementowe lub cementowo-wapienne | min. 28 dni, wilgotność < 4% |

Powłoki farb wapiennych i klejowych należy usunąć. Małe nierówności ścian wyrównać zaprawą klejącą BOLIX P. Nierówności i ubytki powyżej 5 mm wyrównać zaprawą BOLIX W, a na podłogach zastosować posadzkę samoniwelującą BOLIX SN 20.

Podłoża chłonne zagruntować preparatem gruntującym BOLIX N.

Podłoża gipsowe i anhydrytowe przeszlifować grubym papierem ściernym, powstały pył dokładnie usunąć, następnie zagruntować preparatem BOLIX N.

Gładkie, niechłonne powierzchnie betonowe oraz mocne powłoki malarskie przeszlifować grubym papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. Zagruntować preparatem BOLIX BETOGRUNT.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartość opakowania wysypać do pojemnika z odmierzona ilością czystej wody (4,75 ÷ 5,5 litra) i dokładnie mieszać wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do użycia. Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

ZASTOSOWANIE:

Na przygotowane podłoże nałożyć warstwę kontaktową wcierając cienką warstwę kleju gładką krawędzią pacy, a następnie bezwzględnie rozprowadzić warstwę zaprawy o wymaganej grubości za pomocą pacy zębatej odpowiednio dopasowanej do rodzaju i wielkości płytek. Podczas montażu płytek należy dodatkowo nałożyć gładką krawędzią pacy cienką warstwę zaprawy klejącej na spodniej stronie płytki – metoda podwójnego smarowania. Jednorazowo nanieść taką ilość zaprawy, która pozwoli na ułożenie na niej płytek przed rozpoczęciem jej naskórkowania. W przypadku zabrudzenia / zakurzenia spodniej części płytek, przed przyklejeniem powierzchnie te należy dokładnie oczyścić. Płytkę należy przyłożyć do krawędzi wcześniej ułożonych na odległość spoiny i docisnąć do nałożonej zaprawy klejącej, a następnie lekko odsunąć celem równomiernego rozprowadzenia zaprawy i ułożenia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej szerokości spoin w zależności od wielkości płytek oraz warunków eksploatacji – poszczególnych elementów nie układać na styk. Nadmiar zaprawy należy przed jej związaniem na bieżąco usuwać.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX P

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Płytek przed przyklejeniem nie należy moczyć lub zwilżać wodą.
- Nie stosować na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wilgoci.
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do montażu płytek odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do montażu płytek uwzględniając warunki temperaturowo-wilgotnościowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- W czasie montażu okładzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i wiązania zaprawy klejącej.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.
- Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką, stwardniałe zabrudzenia usunąć mechanicznie.
- Świeżo przyklejone płytki chronić przed penetracją wody i działaniem mrozu do czasu związania zaprawy.
- W miejscach występowania dużej wilgotności wewnątrz (kabiny prysznicowe, łazienki, pralnie) w celu właściwego zaizolowania podłoża należy przed przyklejeniem okładziny wykonać powłokę uszczelniającą folią w płynie BOLIX HYDRO oraz taśmą uszczelniającą BOLIX HYDRO-T. Na zewnątrz (na tarasach loggiach oraz balkonach), podłoże należy zaizolować masą dwuskładnikową BOLIX HYDRO-DUO z użyciem taśmy uszczelniającej BOLIX HYDRO-TW.
- Należy pamiętać o właściwym wykonaniu i przeniesieniu dylatacji występujących w podłożu.
- Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu zaprawy czyszczenie jest utrudnione.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min) z mieszadłem koszykowym
- Wiadro
- Paca zębata (wielkość zębów powinna być odpowiednio dobrana do wielkości układanych płytek)
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE:

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie stosowania i wiązania:
od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza w trakcie stosowania i wiązania:
do 80%

Gęstość nasypowa:
ok. 1,50 g/cm³

Barwa:
szara

Grubość warstwy zaprawy klejącej:
2 ÷ 10 mm

Czas użycia po zarobieniu wodą:
do 2h

Czas otwarty pracy:
ok. 20 min

Czas korygowania:
ok. 20 min

Spoinowanie / obciążenie ruchem pieszym:
po min. 24h

Pełne obciążenie:
po min. 3 dniach

Odporność na temperaturę:
-30°C ÷ +70°C

Opakowania:
worek 25 kg

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
48 / ok. 1200 kg

Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:

ok. 1,50 kg/m² / 1 mm grubości ciągłej warstwy zaprawy klejącej
Zużycie wyrobu jest uzależnione od stanu wyrównania podłoża, rodzaju klejonych płytek oraz grubości zaprawy klejącej. W celu określenia dokładnego zużycia, wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed zawilgoceniem. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD:

Spoiva hydrauliczne, polimery, drobnoziarniste wypełniacze mineralne i syntetyczne oraz dodatki modyfikujące.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl


BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX P**Cienkowarstwowa zaprawa klejąca**

	
BOLIX SA, 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8	
09	
Klej do ceramiki BOLIX P kl. C2T	
EN 12004	
1488	
Klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie (szczegóły patrz DWU pkt 3)	
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr 36/EC/2013	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1 / A1 _n
Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki
Przyczepność początkowa	≥1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥1,0 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania- rozmrażania	≥1,0 N/mm ²
Przyczepność po czasie otwartym	≥0,5 N/mm ² po czasie nie krótszym niż 20 minut
Spływ	≤0,5 mm

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

